

令和5年6月7日

株式会社 林工務店
代表取締役 林 徳彦

独立行政法人日本学生支援機構が発行する 「ソーシャルボンド」への投資について

株式会社林工務店（以下当社という）は、この度、独立行政法人日本学生支援機構（以下同機構という）が発行するソーシャルボンド（第71回日本学生支援債券、以下本債券という）への投資を決定いたしましたのでお知らせします。

「ソーシャルボンド」とは、社会的課題の解決に資するプロジェクト（ソーシャルプロジェクト）の資金調達のために発行される債券のことであり、グリーンボンドとともに、ESG投資の対象となります。本債券は、ICMA（国際資本市場協会）が定義するソーシャルボンド原則に適合する旨、世界的なESG評価機関であるムーディーズ・ジャパンからセカンド・パーティー・オピニオンを取得しており、「ソーシャルボンド」として発行されます。

本債券の発行による調達資金は、同機構が担う奨学金事業の内、貸与奨学金の財源として活用されます。奨学金事業は、日本国憲法第26条や教育基本法第4条に定められる「教育の機会均等」や、国連の持続可能な開発目標（SDGs）の内、目標4「すべての人に包括かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する。」の達成に資する等、我が国の教育面の課題解決に貢献します。

当社は、本債券をはじめとしたグリーンボンド・ソーシャルボンドへの投資を継続的に実施することで、今後も社会的責任を果たしてまいります。

<本債券の概要>

銘柄	第71回日本学生支援債券
年限	2年
発行額	300億円
発行日	令和5年6月7日